

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之标的资产过户完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买杭州众硅电子科技有限公司 64.69%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 5 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1147 号）（以下简称“中国证监会批复”），具体内容详见公司于 2026 年 5 月 13 日披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-048）。

公司根据中国证监会批复的要求积极推进本次交易实施事宜。截至本公告披露日，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完毕，具体情况如下：

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产过户

截至本公告日，本次交易所涉标的公司 64.69%股权已过户登记至公司名下，本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕。

（二）本次交易实施后续事项

1、上市公司尚需按照本次交易相关协议的约定向相关交易对方发行股份，并按照有关规定办理新增股份的相关登记、上市手续；

2、上市公司尚需在中国证监会批复的有效期限内择机发行股份募集配套资金，并按照有关规定办理前述发行涉及新增股份的相关登记、上市手续；

3、上市公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本事项修改《公司章程》并办理变更登记、备案手续；

4、上市公司、标的公司及相关各方尚需继续履行本次交易的相关合同、协议及承诺；

5、上市公司及其他交易各方需根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务。

二、本次交易标的资产过户情况的中介机构意见

（一）独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：

“1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规的要求。

2、截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已过户至公司名下，公司已合法持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效。

3、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

（二）法律顾问意见

本次交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所认为：“截至本法律意见书出具之日，本次交易方案的主要内容符合相关法律法规的规定；本次交易已经履行了全部必要的批准和授权程序，相关批准与授权合法有效；本次交易相关协议约定的生效条件已成就，标的资产过户具备实施条件；本次交易标的资产已完成交割过户手续；在本次交易相关协议约定、相关各方承诺得以切实履行的情况下，相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年5月30日